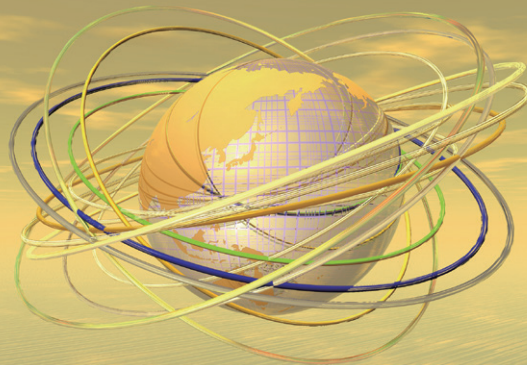


MEIKO
REPORT第50期
株主通信

(2024年4月1日から2025年3月31日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー



財務ハイライト

売上高

206,806 百万円

営業利益

19,083 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

14,924 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2024年3月31日現在	当期末 2025年3月31日現在
資産の部		
流動資産	102,839	114,112
固定資産	127,120	142,253
有形固定資産	112,065	129,570
無形固定資産	6,418	5,696
投資その他の資産	8,636	6,986
資産合計	229,960	256,366
負債の部		
流動負債	81,714	100,257
固定負債	42,786	40,502
負債合計	124,501	140,760
純資産の部		
株主資本	69,566	81,691
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	14,242	13,820
利益剰余金	45,146	57,649
自己株式	△2,710	△2,666
その他の包括利益累計額	28,617	26,547
その他有価証券評価差額金	94	92
繰延ヘッジ損益	45	50
為替換算調整勘定	28,467	26,322
退職給付に係る調整累計額	10	82
純資産合計	105,458	115,605
負債純資産合計	229,960	256,366

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2023年4月1日～ 2024年3月31日	当期(累計) 2024年4月1日～ 2025年3月31日
売上高	179,458	206,806
売上原価	148,910	167,030
売上総利益	30,548	39,775
販売費及び一般管理費	18,887	20,692
営業利益	11,660	19,083
営業外収益	3,917	1,890
営業外費用	1,310	2,210
経常利益	14,267	18,763
特別利益	542	172
特別損失	936	391
税金等調整前当期純利益	13,873	18,544
法人税等	2,458	3,448
当期純利益	11,415	15,096
非支配株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失(△)	105	171
親会社株主に帰属する当期純利益	11,310	14,924

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2023年4月1日～ 2024年3月31日	当期(累計) 2024年4月1日～ 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,357	21,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,586	△24,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	681	4,141
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,577	△373
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,028	1,095
現金及び現金同等物の期首残高	17,334	21,363
連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	—	453
現金及び現金同等物の期末残高	21,363	22,913

財務のポイント

●連結貸借対照表

- 当期連結会計期間末の総資産は256,366百万円となり、前連結会計年度末比26,406百万円増加
- その主な要因は、流動資産において、現金及び預金が1,549百万円増加、売掛金が6,349百万円増加、棚卸資産が2,895百万円増加、固定資産において、有形固定資産が17,504百万円増加、投資有価証券が841百万円減少。
- 当連結会計年度末の負債は、140,760百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,259百万円増加。

- その主な要因は、流動負債において、支払手形及び買掛金が2,566百万円増加、短期借入金が8,153百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が2,175百万円増加、流動負債のその他が5,473百万円増加、固定負債において、長期借入金が2,549百万円減少。
- 当連結会計年度末の純資産は、115,605百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,147百万円増加。
- その主な要因は資本剰余金が421百万円減少、利益剰余金が12,502百万円増加、為替換算調整勘定が2,145百万円減少。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年度の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2024年度連結実績および今期予想

(単位：億円)

		2023年度		2024年度		前期比		2025年度		前期比	
		通期実績	利益率	通期実績	利益率	増減額	増減率	通期予想	利益率	増減額	増減率
売上高	基板	1,492		1,706		214	14.3%	1,740		34	2.0%
	電子機器	303		362		59	19.5%	390		28	7.7%
		1,795		2,068		273	15.2%	2,130		62	3.0%
営業利益	基板	108	7.2%	172	10.1%	64	59.3%	177	10.2%	5	2.9%
	電子機器	9	3.0%	19	5.2%	10	111.1%	23	5.9%	4	21.1%
		117	6.5%	191	9.2%	74	63.7%	200	9.4%	9	4.8%
	経常利益	143	8.0%	188	9.1%	45	31.5%	190	8.9%	2	1.3%
	当期純利益	113	6.3%	149	7.2%	36	32.0%	155	7.3%	6	3.9%
	期中平均為替レート (JPY/USD)	145.31		152.57				140			

商品別売上および今期予想

(単位：億円)

	2023年度 通期実績	2024年度 通期実績	増減額	前期比	2025年度 通期予想	増減額	前期比
車載	947	904	-43	-4.5%	910	6	0.7%
スマートフォン	235	225	-10	-4.3%	225	0	0.0%
情報通信	46	227	181	393.5%	250	23	10.1%
半導体PKG基板	7	10	3	42.9%	15	5	50.0%
モジュール基板	85	134	49	57.6%	135	1	0.7%
アミューズメント、スマート家電、産業機器、その他	172	206	34	19.8%	205	-1	-0.5%
電子機器	303	362	59	19.5%	390	28	7.7%
合計	1,795	2,068	273	15.2%	2,130	62	3.0%

仕様別売上および今期予想

(単位：億円)

	2023年度 通期実績	2024年度 通期実績	増減額	前期比	2025年度 通期予想	増減額	前期比
4層板以下	436	423	-13	-3.0%	390	-33	-7.8%
6層板以下	363	333	-30	-8.3%	340	7	2.1%
多層貫通基板	799	756	-43	-5.4%	730	-26	-3.4%
8層板以下	364	509	145	39.8%	510	1	0.2%
10層板以下	258	378	120	46.5%	430	52	13.8%
ビルドアップ基板	622	887	265	42.6%	940	53	6.0%
半導体PKG基板	7	10	3	42.9%	15	5	50.0%
リジッドフレキシ、フレキシ、放熱、大電流、その他	64	53	-11	-17.2%	55	2	3.8%
EMS	140	185	45	32.1%	200	15	8.1%
ODM	163	177	14	8.6%	190	13	7.3%
電子機器	303	362	59	19.5%	390	28	7.7%
合計	1,795	2,068	273	15.2%	2,130	62	3.0%

2024年度業績について

当連結会計年度における電子部品業界は、自動車市場において需要が低迷する一方で、AIサーバーやゲーム機などの分野では需要が拡大基調で推移しました。期後半では米国新政権発足に伴う大規模な関税の引き上げ方針をめぐり、先行きに対する不透明感が増大しました。

このような環境の下、当社グループでは、車載向け基板は需要低迷の影響を受けました。スマートフォン向け基板は製品構成の変化により前年を割り込みました。情報通信向け基板は衛星通信を中心に大きく増加しました。モジュール基板はSSD、通信モジュールともに好調に推移しました。電子機器事業も大きく増加しました。利益面では、付加価値が高いビルドアップ基板が大幅に増加したことや工場稼働率の向上、生産性の改善と併せ、コスト削減効果等により好調に推移しました。これらより売上高・利益ともに過去最高を更新しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、206,806百万円(前期比15.2%増)と前期と比べ27,347百万円の増収となりました。損益面では、営業利益が19,083百万円(前期比63.7%増)、経常利益が18,763百万円(前期比31.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が14,924百万円(前期比32.0%増)となりました。

2025年度業績予想について

当社グループが属する電子部品業界は、自動運転やこれを支える通信インフラの構築、AI需要拡大などにより高性能な電子部品需要が拡大する見通しとなっております。

2025年度の業績見通しは、為替の前提を140円としました。また米国の大規模な関税の引き上げによる需要低迷を織り込みました。これらによる販売への影響は、為替影響で120億円、関税影響で100億円となります。基板事業では、車載向け基板は北米や中国のEV案件が増加する見通しです。情報通信向け基板は衛星通信を中心に増加する見通しです。スマートフォン向け基板とモジュール基板は前年度並みの見通しです。仕様別にみるとビルドアップ基板が拡大する見通しです。この中でも10層以上の収益性が高い案件を取り込んでまいります。電子機器事業は収益性が高いODM事業を拡大し収益性を向上してまいります。

生産面では、半導体パッケージ基板、モジュール基板の生産を担う石巻第2工場、ベトナム第3工場の早期収益化に取り組むとともに、ベトナム第4工場やホアビン工場の立ち上げに尽力してまいります。

損益面では引き続き、工場の自動化・省人化、歩留まり改善など生産性の改善を推進しさらなる収益性の強化を図ってまいります。

(単位：億円)

2022年度(実績) 2023年度(実績) 2024年度(実績) 2024年度/2022年度 2025年度(予想)

売上高合計	1,673	1,795	2,068	1.2倍	2,130
営業利益	96	117	191	2.0倍	200
営業利益率	5.7%	6.5%	9.2%	1.6倍	9.4%
経常利益	112	143	188	1.7倍	190
当期純利益	88	113	149	1.7倍	155

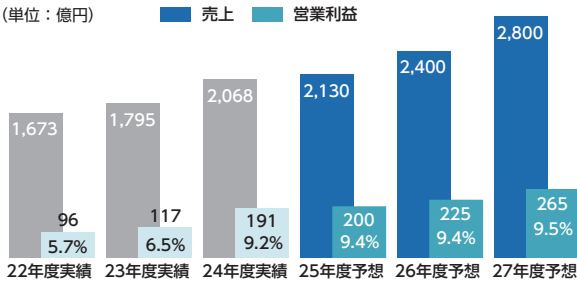
財務指標と株主還元について

1. 設備・研究開発投資を通じ、継続的に売上高・利益を拡大させて行きます。
2. バランスの取れた財務体質の強化を進めて参ります。
3. 連結配当性向は15%を目安とします。
4. 利益を拡大させ、株主価値と配当額の向上に努めます。

今後の見通し

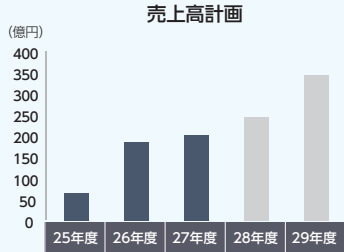
2025年度業績予想は直近の為替、関税影響を織り込み売上高2,130億円、営業利益200億円といたしましたが、今後の成長見通しに大きな変化はありません。このためホアビン工場をはじめとする成長投資については時期を早め、投資額を510億円といたしました。

以下に成長投資の状況についてご説明いたします。



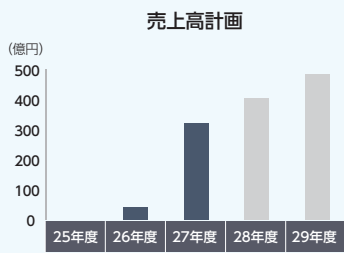
●ベトナム第4工場

ベトナム工場は高稼働が継続しており、今後の需要拡大に対応するため工場の建設を行っています。現在は生産設備の搬入を行っており、7月より部分的に稼働を開始いたします。



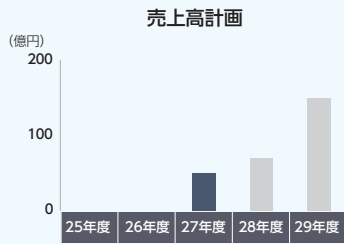
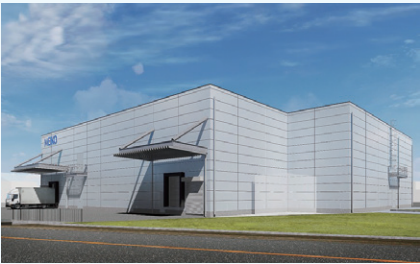
●ホアビン工場

AI機器需要増を受け工場の建設を行っています。現在は生産設備の搬入を行っており、下期より顧客認定を進めてまいります。26年度に生産を開始し、27年度に本格的生産を開始する予定です。



●南陽工場 (EMS)

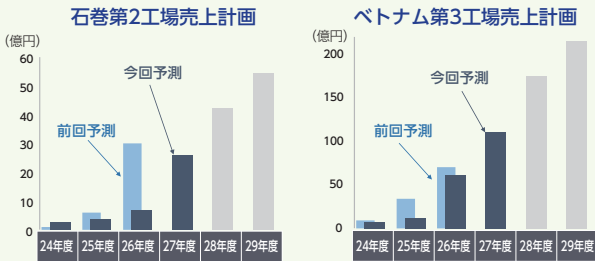
自動運転などに必要な測距装置の生産に対応する工場を建設します。この工場では半導体実装への対応と、光学ユニット用のアクティブアライメントに対応します。25年度に建設を開始し27年度より生産を開始する予定です。



次に、投資は完了しているパッケージ事業と天童工場の状況をご説明します。

●パッケージ事業の状況

市況影響を受け計画に遅れがでております。引き続き黒字化に向け尽力してまいります。

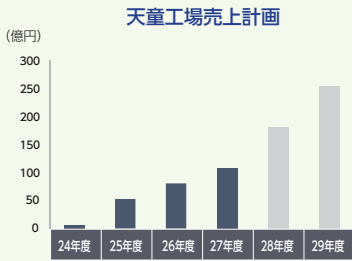


●天童工場の状況

顧客認定が進み徐々に量産が開始されます。また、天童開発センターを立ち上げてまいります。

天童開発センターの狙い

- ・産学連携開発案件強化
- ・米沢ODM事業との連携
- ・新規開発商品の量産化



株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

	2022年度(実績)	2023年度(実績)	2024年度(実績)	2024年度/2022年度	2025年度(予想)
投資額	174	199	298	1.7倍	510
研究開発費	45	53	63	1.4倍	65
EBITDA	194	228	316	1.6倍	339
純資産合計	845	1,055	1,156	1.4倍	1,254
有利子負債残高	753	793	868	1.2倍	1,167
自己資本比率	38.2%	42.7%	42.2%	1.1倍	43.5%
D/Eレシオ	0.89	0.75	0.75	0.8倍	0.93
ROE	10.5%	10.7%	12.9%	1.2倍	12.3%

	2022年度(実績)	2023年度(実績)	2024年度(実績)	2024年度/2022年度	2025年度(予想)
株価	2,922円	5,420円	6,840円	2.3倍	-
時価総額	749	1,390	1,776	2.4倍	-
EPS	338.94円	428.70円	569.47円	1.7倍	591.78円
PER	8.47倍	12.29倍	12.03倍	1.4倍	-
PBR	0.97倍	1.42倍	1.51倍	1.6倍	-
配当額	55円	68円	88円	1.6倍	90円
配当性向	16.2%	15.9%	15.5%	-	15.2%
ドル円為替レート	136.00円	145.31円	152.57円	-	140円

監査役
橋本 真一

2024年の株主総会で選任いただき、社外監査役として職務を遂行させていただいております。2024年は創立50周年記念の年であり、また年度の売上高が2,000億円の大台を突破した年となりました。事業規模が拡大するなかで企業価値を維持・向上させるために質的なガバナンスの向上が求められますので、社外監査役という立場で会社の発展に貢献していきたいと思っております。

今年の世界情勢はトランプ大統領の就任以降、世界の紛争解決に向けた動きやトランプ関税を手始めとした米国の経済政策などで、暫くは混沌とした情勢が続いていくものと思われます。このような世界情勢のなかでも、これまでの50年間で培った生産力・技術力・販売力、ここから生まれたグローバルな競争体制やポートフォリオの多様性に更に磨きをかけて、将来の企業価値向上に向けた取り組みが重要となります。

昨今、企業の経営問題に対する社外役員の有効性が問われているなかではありますが、ステークホルダーの皆様へのご期待に沿えるよう尽力してまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

コーポレートデータ (2025年3月31日現在)

会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	12,706名(連結) (国内1,358名・海外11,348名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

役員

代表取締役社長執行役員	名 屋 佑 一 郎
代表取締役副社長執行役員	坂 手 敦
取締役専務執行役員	和 田 純 也
取締役常務執行役員	桔 梗 芳 人
取締役常務執行役員	名 屋 茂
取締役	土 屋 奈 生
取締役	西 山 洋 介
取締役	原 田 隆
取締役	小 林 俊 文
常勤監査役	松 田 孝 広
監査役	江 尻 琴 美
監査役	橋 本 真 一

関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社宮城メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
メイコーエレクトロニクス株式会社	電子関連事業
メイコーエレクトロニクス株式会社	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
広州市斯皮德貿易有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hoa Binh Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hai Duong Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業

株式情報

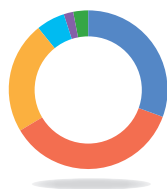
発行可能株式総数	普通株式	70,000,000株
	第一回社債型種類株式	100株
発行済株式の総数	普通株式	26,000,673株
	(自己株式 802,647株を除く)	
	第一回社債型種類株式	70株
株主数	普通株式	3,472名
	第一回社債型種類株式	1名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,817	14.68
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3,216	12.37
CLEARSTREAM BANKING S.A.	975	3.75
名幸興産株式会社	608	2.34
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC /FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	582	2.24
有限会社ユーホー	521	2.00
JP MORGAN CHASE BANK 385632	438	1.69
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT	392	1.51
株式会社三井住友銀行	377	1.45

※当社は、自己株式802,647株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況



個人・その他	30.70%
金融機関	35.72%
外国法人等	22.81%
その他の法人	5.79%
金融商品取引業者	1.99%
自己名義	2.99%

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基準日 期末配当金 毎年3月31日
中間配当金 毎年9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
および特別口座 三井住友信託銀行株式会社
の口座管理機関

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(郵便物送付先) 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(電話照会先) ☎ 0120-782-031

上場証券取引所 東京証券取引所 プライム市場

公告の方法 電子公告により当社ウェブサイトに掲載
<https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml>
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。